

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年3月24日(24.03.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/059091 A1

- (51) 国際特許分類:
B65F 1/00 (2006.01) *C08L 23/00* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/035075
- (22) 国際出願日: 2020年9月16日(16.09.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 日本サニパック株式会社
(SANIPAK COMPANY OF JAPAN, LTD.) [JP/
JP]; 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1 丁
目 2 5 番地 5 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 堀籠 良博 (HORIGOME Yoshihiro);
〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1 丁目 2 5 番地
5 日本サニパック株式会社内 Tokyo (JP). 大
崎 学 (OSAKI Manabu); 〒1510072 東京都渋谷
区幡ヶ谷 1 丁目 2 5 番地 5 日本サニパック株
式会社内 Tokyo (JP). 山本 圭輔 (YAMAMOTO
Keisuke); 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1 丁
目 2 5 番地 5 日本サニパック株式会社内
Tokyo (JP). 中川 康弘 (NAKAGAWA Yasuhiro);
〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1 丁目 2 5 番地
5 日本サニパック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 西澤 和純, 外 (NISHIZAWA Kazuyoshi
et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一
丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** POLYETHYLENE-BASED RESIN COMPOSITION, POLYETHYLENE-BASED RESIN PACKAGING MATERIAL, AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: ポリエチレン系樹脂組成物、ポリエチレン系樹脂包装材、及びそれらの製造方法

(57) **Abstract:** The purpose of the present invention is to provide: a polyethylene-based resin composition from which a film can be obtained which has excellent moldability even when an inorganic compound is added, and has excellent bag-making processability and film strength; and a polyethylene-based resin packaging material using the polyethylene-based resin composition. A polyethylene-based resin composition comprises an inorganic compound and an ethylene- α -olefin copolymer, wherein the content of the resin component is 25-90 mass% (exclusive of 90), the ratio of the ethylene- α -olefin copolymer in the resin component is 50 mass% or more, and the ratio of an ethylene- α -olefin copolymer A, which is obtained by being polymerized with a metallocene catalyst in the ethylene- α -olefin copolymer, is 10 mass% or more.

(57) 要約: 本発明は、無機化合物が添加されていても成形性に優れ、製袋加工性及びフィルム強度に優れたフィルムが得られるポリエチレン系樹脂組成物、及び、それを用いたポリエチレン系樹脂包装材を提供することを目的とする。無機化合物と、エチレン- α -オレフィン共重合体とを含むポリエチレン系樹脂組成物において、樹脂成分の含有量を25質量%以上90質量%未満とし、樹脂成分中のエチレン- α -オレフィン共重合体の割合を50質量%以上とし、エチレン- α -オレフィン共重合体中のメタロセン系触媒により重合されてなるエチレン- α -オレフィン共重合体Aの割合を10質量%以上とする。

WO 2022/059091 A1